



ENTREGA DE ACTIVIDADES				No.	
				Curso:	
Datos del alumno				Logotipo Personal	
Apellido, Nombre	Sohom Cutz Miqueas Franklin	Bloque	2		
Clave	4				
Fecha de entrega	"1/04/2022"	Hora	8:30		

Nota: al terminar de adjuntar la información a su proyecto, convertir el documento en formato PDF, el formato de texto deberá ser: alienación de texto *justificado*, tipos de fuente Courier New 12puntos, imágenes centradas y agregar un marco de imagen.

RAM, procesador y motherboard.

1. Tema 1

RAM: Las tarjetas RAM también son consideradas dispositivos de almacenamiento. Las tarjetas RAM tiene dos tipos; las memorias de tipo DDR (Double Data Rate) se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de las de tipo SDR (Single Data Rate), que solo ejecutan una operación de lectura o escritura.



2. Tema 2

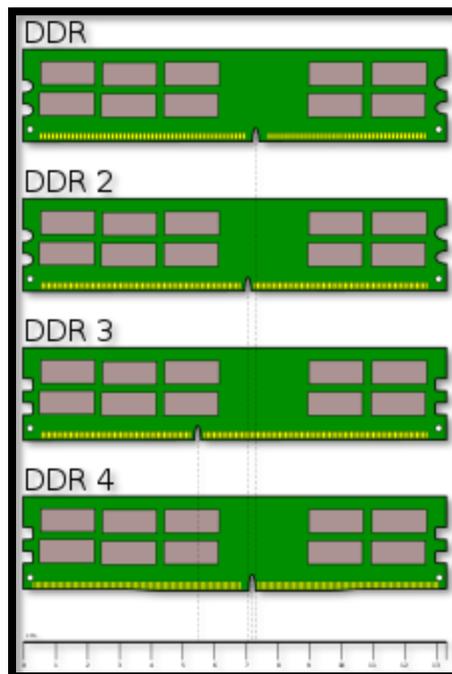
Clasificación de las RAM:

DDR: Son las tarjetas RAM de primeras generaciones que cuentan con 184 pines de contacto en la parte inferior, con capacidad mínima de 500MB y máxima de 1GB de 100MHZ

DDR2: permiten que los búferes de entrada/salida funcionen al doble de la frecuencia del núcleo, permitiendo que durante cada ciclo de reloj se realicen cuatro transferencias y capacidades de 2BG a 4GB

DDR3: se utiliza como medio de almacenamiento primario, en computadores y portátiles modernos equipados con procesadores AMD® e Intel® multi core (2 núcleos (dual core), 4 núcleos (quad core) y 6 núcleos (hexa core) y una capacidad de 4GB a 8GB

DDR4: es capaz de lograr una mayor velocidad y eficiencia gracias a mayores tasas de transferencia y menor voltaje y capacidades de 8GB a 24GB



3. Tema 3

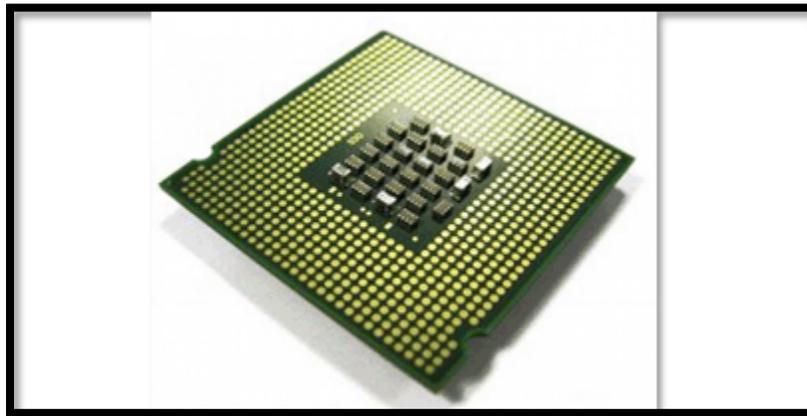
Procesador: Elemento que procesa todo contenido

-Una pastilla de silicio

El procesador esta cubierto de algo que llamamos encapsulado y de lo cual estos 3 tipos:

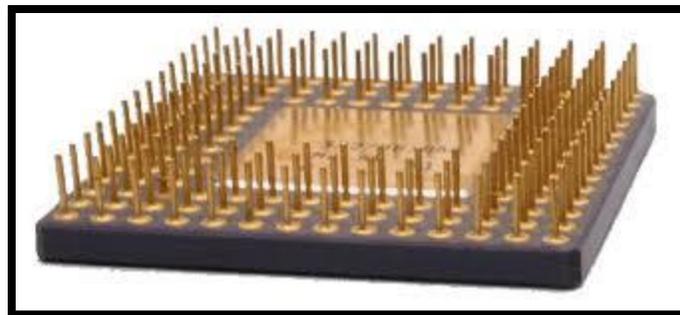
1. Encapsulado LGA Land Grind Array

es la placa base la que tiene los pines, mientras que en el procesador se encuentran las zonas de contacto. Este socket fue reemplazado por LGA 1156 y LGA 1366.



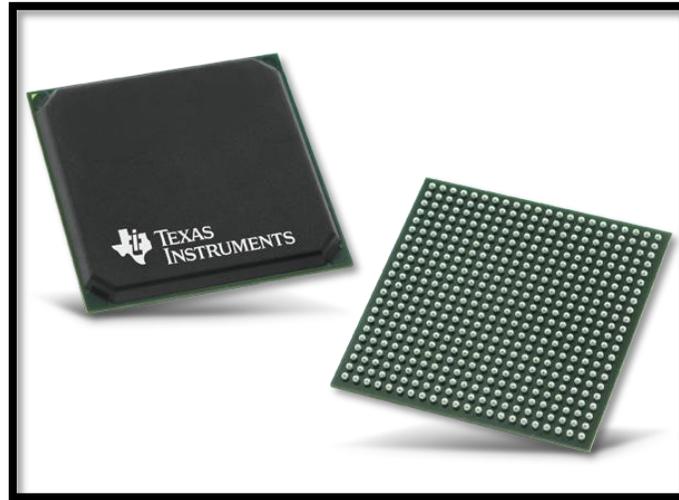
2. Encapsulado PGA Pin Array

La matriz de rejilla de pines es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y circuitos integrados o microchips. También se denomina de la misma forma a la cápsula o empaquetado de los circuitos integrados



3. Encapsulado BGA Ball Grid Array

significa Matriz de Rejilla de Bolas en español y se trata de un conector que, en lugar de utilizar pines para la conexión, se sirve de una especie de almohadilla con una pequeña bola de soldadura adherida de entre 0,3 y 1,5 mm



4. Tema 4

Marcas de procesadores:

1. Intel: Intel Corporation es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según su cifra de negocio anual. La compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores x86, los procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de las computadoras personales

Procesadores de Intel:

Core™ i3, para un desempeño de gaming de nivel básico

Core™ i5, para un desempeño de gaming de nivel medio.

Core™ i7, para un desempeño de gaming de alto nivel.

Core™ i9, para un desempeño de gaming de nivel superior.

Y de ellos hay tres tipos de procesadores; Pentium, Pentium gold, Core y celeron



2. AMD: Advanced Micro Devices, Inc. es una compañía estadounidense de semiconductores con sede en Santa Clara, California, que desarrolla procesadores de computación y productos tecnológicos similares de consumo.

Procesadore AMD:

AMD Threadripper.

AMD Ryzen para escritorio y portátiles.

APU AMD Ryzen.

APU AMD Athlon.

AMD Ryzen y Athlon para portátiles.



5. Tema 5

3. Placa Madre: La placa base es esa en la que se conectan todos los componentes internos del ordenador, desde el procesador hasta los discos duros, la memoria RAM o la tarjeta gráfica. Cada uno de estos componentes tiene su propia ranura para que puedas conectarla.



6. Tema 6